

Resumo

O relatório, aqui exposto, pretende abranger, o trabalho realizado como estagiário na Empresa Qimonda PT ao longo de seis meses.

O estágio efectuou-se na área de Processos de Fabrico, mais concretamente, no processo de Moldação dos Semicondutores, com o objectivo, de identificar um material alternativo a ser utilizado na limpeza dos moldes, tendo em vista a minimização das falhas por contaminações por latão.

O estágio inseriu-se num projecto de Lean Six Sigma, metodologia recentemente implementada na empresa e baseou-se numa causa identificada no projecto para as contaminações, causa essa, o uso de latão na limpeza de moldes.

Como o latão libertava resíduos no molde que contaminavam as unidades produzidas, foram encontradas duas soluções para o problema: um novo material a ser utilizado na limpeza dos moldes, o bambu, e um substrato de latão para ser moldado depois de utilizado o latão não se contaminando material produtivo.